

## Main Options of A12 Prober



- RFID / FOUP ID读取器
- OCR晶圆ID读取器 (顶部/底部)
- 3个暂存晶圆缓冲托盘
- 装载机微环境
- 自动探针卡更换器
- 卡盘: 高/低/常温
- 实时地图数据
- 一键式接触针测
- PMAI: 探针标记自动检查
- PLV: Prober日志查看器
- RCS: 远程控制系统
- DUT编辑器和Recipe 编辑器

## Specifications of A12 Prober

Main body	X-Y axis	Accuracy : $\pm 2\mu\text{m}$
		Resolution: $0.02\mu\text{m}$
		Probing area: X $\pm 170\text{mm}$ , Y -180 , +600mm
		Maximum speed : 240mm/s
Main body	Z axis	Accuracy : $\leq \pm 2\mu\text{m}$
		Resolution: $0.02\mu\text{m}$
		Maximum Z movement: 0 ~ 80mm
Main body	$\theta$ axis	Rotation Range : $\pm 10^\circ$
		Resolution: $0.0001^\circ$
Loader	Cassette / Wafer Size	$\Phi 200\text{mm}$ , $\Phi 300\text{mm}$
Monitor		15 inch High-resolution color LCD
Facility Requirement		Power :50/60Hz AC 208V, CDA: 0.4 to 0.8Mpa , Vacuum: -53 to -100Kpa
Dimensions & Weight		WxDxH: 1700 x 1820 x 1015 mm, 2200 KG (standard).

## 深圳市森美协尔科技有限公司

SEMISHARE CO.,LTD.

公司地址: 深圳市宝安区西乡街道恒丰工业城C1栋3楼

电话: 0755-2690 6952 传真: 0755-8529 9649

邮箱: sales@semishare.com

网址: www.semishare.com



企业网站

### SALES OFFICE

#### Shenzhen office

Email: Dora@semishare.com

Tel: (86) 177 2741 5912

#### Hongkong office

Email: Dora@semishare.com

Tel: (86) 177 2741 5912

#### Beijing office

Email: Peter@semishare.com

Tel: (86) 153 3874 5912

#### Singapore office

Email: windy-luo@semishare.com

Tel: (86) 180 2547 4262

#### Shanghai office

Email: Wade@semishare.com

Tel: (86) 188 2025 3316

#### Europe office

Email: windy-luo@semishare.com

Tel: (86) 180 2547 4262

# SEMISHARE

# A12 全自动探针台

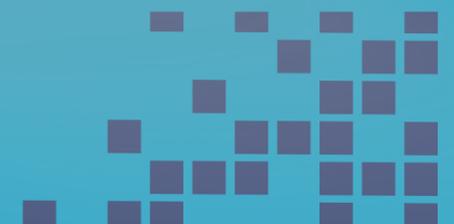
The technology for automatic wafer probing and testing

Auto-High Performance™

Patent: 201910551106.3



Advanced wafer prober manufacturer



## Key features of SEMISHARE A12 wafer prober

高精度  
低振动  
高强度低重心设计  
先进的光学图像识别  
混合智能算法系统



## SEMISHARE-A12 Wafer Probing Machine

A12是一款12寸(兼容8寸)的高性能晶圆测试探针台,设备可与不同类型的ATE测试机组合使用,通过让探针卡与晶圆之间精准接触,实现晶圆级测试,该设备操作简单并具有良好的机械稳定性,能为客户提供一个低成本且高产出的晶圆测试解决方案,满足晶圆厂、封测厂等不同客户的测试需求。

创新性的A12探针台在晶圆自动上下片装载输送、微米级全闭环运动控制、Wafer自动精准对针、视觉自动精确校准、高速反馈通信、数据信息处理等技术方面作出了全新升级改进,设备采用了一种高稳定的晶圆探针测试技术。

## Auto-High Performance™ 技术

Auto-High Performance™ 技术(发明专利:201910551106.3)提供一种高稳定的晶圆探针测试技术,通过对探针台进行多重加固结构和稳定性设计,解决了晶圆测试时设备容易晃动并影响测试精度的问题,保证了晶圆测试过程中探针台的运动稳定性和精密度。

### 减少晶圆加载时间:

缺口和晶圆ID同步识别的一种改进方法。

### 高强度和低重心设计:

支持高针数探针卡,卡盘最大承载力可达200KG。

## 人性化用户界面GUI

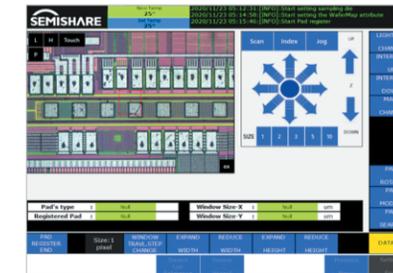
### Initial Information 初始信息



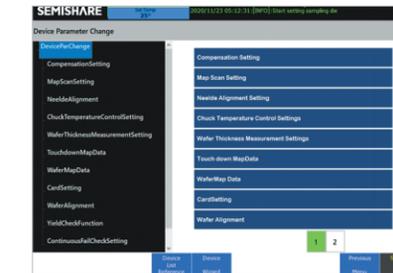
### Wafer ID Reading 晶圆ID读取



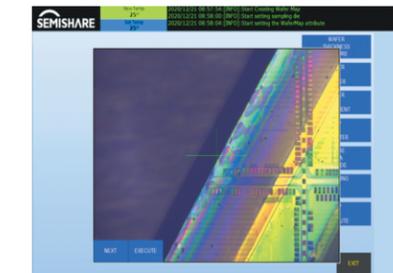
### PAD Registration PAD注册



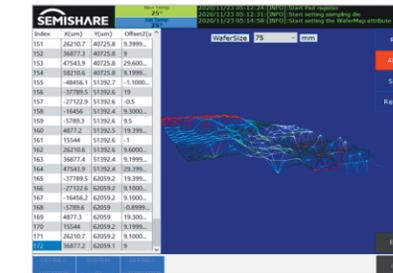
### Recipe Parameter Settings 程序参数设置



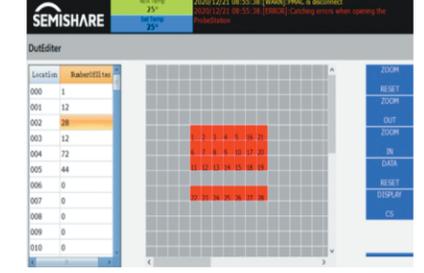
### Wafer Edge Measurement 晶圆边缘测量



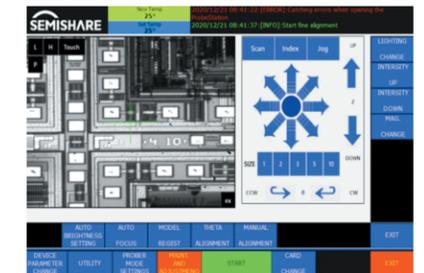
### Contact Compensation 接触补偿



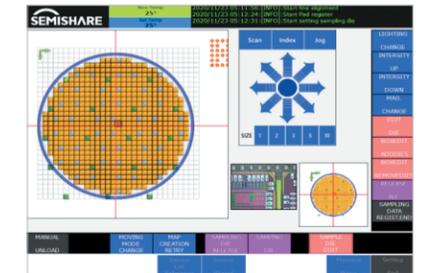
### Multi DUT Location Edit 多DUT位置编辑



### Index & Z height 图像索引&z轴高度调节



### Real-time Wafer Map Data 实时晶圆图数据



## 软件功能

